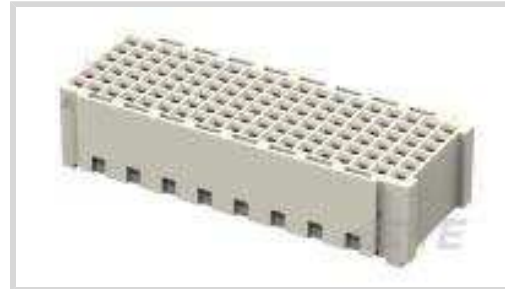




Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen > Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder, Stiftleiste und Buchse



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Buchse für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **114**

Zeilenanzahl: **6**

[Alle Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder, Stiftleiste und Buchse \(34\)](#)

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Buchse für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Ja
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	114
Zeilenanzahl	6
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

### Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	750 VAC
Arbeitsspannung	250 VAC

### Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------

### Kontaktmerkmale

--	--

Kontaktaufbau	Matrix
Flachkontaktbreite	.43 mm[.017 in]
Flachkontaktdicke	.46 mm[.018 in]
Kontaktform	Quadratisch
Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers	Hell
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Kontaktmaterial	Beryllium-Kupfer
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	1.27 µm[49.9999 µin]
Kontakttyp	Stecksockel
Kontakt-nennstrom (max.)	1.5 A

#### Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage – Lotkugel
-------------------------------------	-------------------------------

#### Montage und Anschlusstechnik

Montageausrichtungstyp für Leiterplatte	Keine
Art der Leiterplattenmontage	Löt-kugel
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Polarisierflachstecker
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

#### Gehäusemerkmale

Steckeingangsposition	Oben
Raster	1.27 mm[.05 in]
Gehäusematerial	LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

#### Abmessungen

Steckverbinderhöhe	6 mm[.236 in]
Reihenabstand	1.27 mm[.05 in]
Stapelhöhe	10 mm[.394 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	2.36 mm[.093 in]

#### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
---------------------------	----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Satzverarbeitungsfunktion	Hub- und Schwenkabdeckung
Stromkreis Anwendung	Signal

### Industriestandards

Industriestandard	VITA 61
UL-Brandschutzklasse	Nein

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	450
Verpackungs-Typ	Band und Rolle

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 245 °C

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



## Auch serienmäßig | AMP Mezalok



## Kunden kauften auch diese Produkte



## Dokumente

### Produktzeichnungen

Mezalok, Socket, 114 p, 10 mm, 50 Au, LF

Englisch

### CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2102061-2\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2102061-2\\_K.3d\\_igs.zip](#)

Englisch



## Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2102061-2\\_K.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

## Datenblätter/ Katalogseiten

[SOSA Aligned Interconnect Solutions](#)

Englisch

[Mezalok Connector Brochure](#)

Englisch

## Produktspezifikationen

[Produktspezifikation](#)

Englisch

## Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch